中国国际金融股份有限公司

关于合肥晶合集成电路股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市的

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

CICC
中金公司

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

中国国际金融股份有限公司

关于合肥晶合集成电路股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市的上市保荐书

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”、“公司”或“发行人”）拟申请首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”、“本保荐机构”、“本机构”）作为首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市保荐书内容与格式指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》中相同的含义。）

一、发行人基本情况

（一）基本信息

公司名称	合肥晶合集成电路股份有限公司
注册地址	安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号
有限公司成立日期	2015 年 5 月 19 日
股份公司成立日期	2020 年 11 月 25 日
联系电话	0551-62637000
经营范围	集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次证券发行类型	首次公开发行股票并在科创板上市

（二）主营业务

发行人主要从事 12 英寸晶圆代工业务，致力于研发并应用行业先进的工艺，为客户提供多种制程节点、不同工艺平台的晶圆代工服务。发行人目前已实现 150nm 至 90nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的量产，正在进行 55nm 制程节点的 12 英寸晶圆代工平台的**风险量产**。发行人已具备 DDIC、CIS、MCU、PMIC、Mini LED、E-Tag 等工艺平台晶圆代工的技术能力。发行人所代工的主要产品为面板显示驱动芯片，其被广泛应用于液晶面板领域，包括电视、显示屏、笔记本电脑、平板电脑、手机、智能穿戴设备等产品中，获得了众多境内外知名芯片设计公司和终端产品公司的认可。2021 年度，公司 12 英寸晶圆代工产能为 57.09 万片。根据 Frost & Sullivan 的统计，截至 2020 年底，发行人已成为中国大陆收入第三大、12 英寸晶圆代工产能第三大的纯晶圆代工企业（不含外资控股企业）。

自设立以来，发行人主营业务未发生重大变化。

（三）核心技术

截至报告期末，发行人的主要核心技术平台情况如下：

序号	产品应用领域类别	技术平台	技术参数与工艺特点	终端应用领域	技术先进性	技术来源
1	LCD 显示驱动	90nm 触控与显示驱动整合芯片平台	核心组件电压：1.2/1.32V 输入/输出电压：6V,并提供高压 32V 采用铝制程技术	高阶智能手机、平板电脑、手表等电子产品	国际主流	技术引进并创新升级
		90nm 中大尺寸显示驱动芯片	核心组件电压：1.2-1.5V 输入/输出电压：±6V 采用铝制程技术	笔记本电脑	国际主流	技术引进并创新升级
		110nm 显示驱动芯片平台	核心组件电压：1.2V/1.5V 输入/输出电压：6V,并提供高压 32V 采用铝制程技术	智能手机、笔记本电脑、平板电脑	国际主流	技术引进并创新升级
		110nm 高阶显示驱动芯片平台	核心组件电压：1.5V 输入/输出电压：6V,并提供高压 32V 金属层进行 90%尺寸微缩，采用铝制程技术 采用低漏电元件技术	智能手机、笔记本电脑、平板电脑	国际主流	技术引进并创新升级
		150nm 显示驱动芯片平台	核心组件电压：1.8V/3.3V 输入/输出电压：13.5V/18V	4K/8K 电视显示屏、电脑显示屏	国际主流	技术引进并创新升级
2	LED 显示驱动	110nmLED 显示驱动芯片平台	核心组件电压：1.5V 输入/输出电压：5V	LED 广告牌、LED 背光	国际主流	自主研发
		110nmLED 驱动芯片平台	核心组件电压：5V	LED 灯带	国际主流	自主研发
3	CIS	90nmCMOS 图像传感器平台	核心组件电压：1.2V 输入/输出电压：3.3V 像素尺寸：1.4μm 采用前照度（FSI）技术	手机摄像头芯片、3D 识别芯片、安防监控芯片等	国内领先	自主研发
4	E-tag	110nm 中高阶电子标签驱动芯片平台	核心组件电压：1.5V 输入/输出电压：6V,并提供高压 40V 高压元件为沟道隔离元件，可大幅缩小尺寸	电子标签及便携式装置	国内领先	自主研发
5	MCU	新一代 110nm 加强型微控制器平台	核心组件电压：1.5V 输入/输出电压：5V MTP 容量大小：32kx8 bits; 读写次数：10k cycles	智能家电芯片、物联网芯片	国内主流	自主研发

（四）研发水平

1、承担的重大科研项目

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已承担以下项目的研发工作，具体情况如下：

序号	项目（课题）名称	项目类别	主管单位	项目执行期	财政预算	报告期内收到的政府补助金额（万元）	计入报告期损益金额（万元）
1	高集成度 CMOS 图像传感器设计与制造关键技术研发	省级	安徽省科技厅	2020/10-2023/9	1,800.00	1,150.00	-
2	110nmMCU 项目	省级	安徽省发改委	2018/1-2020/11	1,023.00	1,023.00	661.76

注：上表“高集成度 CMOS 图像传感器设计与制造关键技术研发”项目收到的政府补助 1,150 万元，为政府支付给发行人和合作方的合计金额

2、核心学术期刊论文发表情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司核心技术人员在集成电路相关重要学会及主要期刊上发表的主要论文情况如下：

序号	论文名称	会议/期刊名称	作者	发表时间
1	High Endurance Phase Change Memory Chip Implemented based on Carbon-doped Ge2Sb2Te5 in 40 nm Node for Embedded Application	IEEE	Z. T. Song D. L. Cai X. Li L. Wang Y. F. ChenH. P. Chen Q. Wang Y. P. Zhan（詹奕鹏） M. H. Ji	2018
2	A 40-nm 16-Mb Contact-Programming Mask ROM Using Dual Trench Isolation Diode Bitcell	IEEE	Yong Ye Yong Kang Chao Zhang Yipeng Chan（詹奕鹏） Hanming Wu Shiuhwuu Lee Zhitang Song Bomy Chen	2016
3	Failure Analysis of Nitrogen-Doped Ge2Sb2Te5 Phase Change Memory	IEEE	Dan Gao Bo Liu Zhen Xu Ying Li Lei Wang Zhitang Song Nanfei Zhu Yipeng Zhan（詹奕鹏） Songlin Feng	2016

（五）主要经营和财务数据及指标

报告期内，发行人主要经营和财务数据及指标如下：

项目	**2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度**	**2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度**	**2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度**
资产总额（万元）	3,127,227.47	1,564,233.24	1,137,349.83

项目	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度
归属于母公司所有者权益（万元）	922,265.35	715,793.43	382,956.22
资产负债率（合并）	68.38%	54.24%	66.33%
资产负债率（母公司）	70.60%	54.19%	66.25%
营业收入（万元）	542,900.93	151,237.05	53,392.17
净利润（万元）	172,883.20	-125,759.71	-124,302.67
归属于母公司所有者的净利润（万元）	172,883.20	-125,759.71	-124,302.67
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	153,364.72	-123,333.42	-134,752.99
基本每股收益（元）	1.15	-0.27	-
稀释每股收益（元）	1.15	-0.27	-
加权平均净资产收益率	21.55%	-28.93%	-27.94%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	957,388.50	47,282.88	-18,303.30
现金分红（万元）	-	-	-
研发费用占营业收入比例	7.31%	16.18%	31.87%

（六）发行人存在的主要风险

1、技术风险

（1）制程节点技术研发滞后的风险

发行人所处的晶圆代工行业技术更新迭代快，研发周期长。自设立至今，发行人专注于 12 英寸晶圆代工业务，已实现 150nm-90nm 制程节点量产，正在进行 55nm 制程技术平台的**风险量产**，但台积电、联华电子、中芯国际等行业领先企业已达 5nm、14nm 等制程节点，发行人与之存在差距。根据发行人规划，发行人拟进一步研发更先进制程，技术研发难度不断增加，对工艺、设备、原材料、研发人员的要求将进一步提升。如无法及时完成相关技术平台的研发以响应市场需求，将对发行人的市场竞争力及市场份额造成不利影响。

（2）工艺平台技术研发无法满足市场需求的风险

发行人报告期内形成主营业务收入的工艺平台应用领域主要为 DDIC，正在研发中的工艺平台应用领域主要为 CIS、MCU 及 PMIC。以上工艺平台的终端市场应用主要为

液晶面板、手机、车用、消费电子等，具有技术革新速度快、产品需求多元化等特点。如发行人工艺平台技术研发方向、进度、成果等无法满足市场需求，将可能导致发行人前期研发投入难以收回、发行人代工服务应用领域难以拓展，对发行人经营造成不利影响。

（3）技术研发投入不足的风险

发行人所处的晶圆代工行业研发投入大，随着制程不断缩小，研发投入将进一步增长。报告期内，发行人研发费用分别为 17,017.80 万元、24,467.56 万元及 39,668.49 万元，占营业收入比重分别为 31.87%、16.18%及 7.31%。如发行人后续研发投入不足，亦可能造成研发进度滞后，导致发行人失去技术优势并存在产品被竞争对手替代的风险，从而对公司稳定经营产生不利影响。

（4）研发人员不足或流失的风险

发行人所处的晶圆代工行业属于技术密集型行业，技术研发涉及多学科交叉，生产工艺流程复杂，对研发人员专业程度、经验水平均有较高要求。不断吸纳技术人才、持续扩充研发团队是集成电路企业增加竞争力的重要因素。近年来，我国集成电路行业发展迅速，但相关人才储备仍有缺口，人员专业程度存在不足。目前集成电路行业人才争夺较为激烈、人员流动较为频繁。

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人研发人员 480 人，占发行人员工比例 17.65%。发行人正在进行 55nm 低功耗逻辑及触控与显示驱动整合技术等技术平台的研发、**风险量产**工作，人才需求较大。如发行人无法持续吸引人才并扩充研发团队，或发行人无法留住研发人员并保持研发团队的稳定性，将对发行人的技术研发及生产经营造成不利影响。

2、经营风险

（1）晶圆代工业务投资规模大，受下游景气度影响较大的风险

发行人所处的晶圆代工行业技术更新迭代快、资金投入大、研发周期长，属于典型的资本密集型行业，固定资产投资的需求较高、设备购置成本高，而发行人近年来不断进行产能扩充，固定资产投资规模较大。截至 2021 年末，发行人固定资产的账面价值为 1,632,598.75 万元，占发行人总资产的比例为 52.21%；发行人在建工程的账面价值为 332,905.83 万元，占发行人总资产的比例为 10.65%。未来，发行人将进一步扩充产能并提高研发投入以满足下游客户对发行人稳定性更高、平台更多元的晶圆代工服务需求，

发行人也将提高对固定资产的投入，资金筹措能力面临较大的考验。

同时，2019 年-2021 年间，发行人营业收入由 53,392.17 万元上升至 542,900.93 万元，年均复合增长率达到 218.88%。发行人营业收入快速增长与下游市场需求息息相关。2018 年-2020 年间，中国大陆晶圆代工行业市场规模由 107.3 亿美元上升至 148.9 亿美元，年均复合增长率为 17.8%；中国大陆 DDIC 出货量由 38.5 亿颗上升至 52.7 亿颗，年均复合增长率为 17%。晶圆代工行业受下游景气度影响较大，不排除未来市场规模变化、行业竞争加剧、产品更新换代等因素综合影响，导致下游市场需求发生波动进而对发行人业绩造成不利影响。

报告期各期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-18,303.30 万元、47,282.88 万元和 957,388.50 万元。如发行人无法维持充足的现金流，导致业务拓展困难、市场开拓无法达到预期；或未能及时应对下游市场变化，导致经营业绩下滑，将对公司稳定经营产生不利影响。

（2）发行人与行业领先企业相比，在技术水平、业务规模、盈利能力等方面存在较大差距的风险

技术水平方面，自设立至今，发行人专注于 12 英寸晶圆代工业务，已实现 150nm-90nm 制程节点量产，正在进行 55nm 制程技术平台的**风险量产**。但台积电、联华电子、中芯国际等全球行业领先企业已达 5nm、14nm 等制程节点，发行人与之存在较大差距。

业务规模和盈利能力方面，报告期内，发行人主营业务收入分别为 53,336.01 万元、151,186.11 万元和 542,084.44 万元；产能分别为 182,117 片/年、266,237 片/年和 570,922 片/年；综合毛利率分别为-100.55%、-8.57%和 45.13%；净利润分别为-124,302.67 万元、-125,759.71 万元和 172,883.20 万元，毛利率、业务规模和市场占有率低于台积电、联华电子等行业领先企业，发行人在业务规模和盈利能力等方面与行业领先企业存在较大差距。

如果发行人无法在未来持续推动技术进步，丰富产品结构、拓展客户、提高业务规模和市场占有率、增强盈利能力，将可能难以缩短与行业领先企业的差距，在激烈的市场竞争中受到不利影响。

（3）晶圆代工服务的产品应用领域单一，后续研发投入大，业务拓展面临技术风险

报告期内，发行人主要从事 12 英寸晶圆代工业务，主要向客户提供 DDIC 及其他工艺平台的晶圆代工服务，上述晶圆代工服务的产品应用领域主要为面板显示驱动芯片领域。报告期内，发行人 DDIC 晶圆代工服务形成的收入合计分别为 53,333.24 万元、148,394.24 万元和 467,914.67 万元，占主营业务收入的比例分别为 99.99%、98.15%和 86.32%，形成主营业务收入的晶圆代工服务的产品应用领域较为单一。

晶圆代工客户对发行人技术迭代和产品多元化的要求日益提高。报告期内，发行人研发费用分别为 17,017.80 万元、24,467.56 万元和 39,668.49 万元，呈逐年上升趋势，主要用于 55nm 先进制程研发，以及 CIS、MCU、PMIC 等其他产品技术平台拓展；未来，发行人将投入 49 亿元募集资金用于合肥晶合集成电路先进工艺研发项目，其中包括 55nm 后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台、40nm MCU 工艺平台、40nm 逻辑芯片工艺平台、28nm 逻辑及 OLED 芯片工艺平台等项目研发。随着制程节点进一步提升及技术平台种类增加，预计发行人研发投入将持续增长。

如发行人在面板显示驱动芯片领域客户订单流失或议价能力下降，且未能及时完成 CIS、MCU 的扩产和 PMIC 等其他技术平台的研发及量产工作，无法在短时间内形成多元化的产品应用领域结构，或先进制程节点研发进度滞后，则可能对发行人的经营业绩造成不利影响。

（4）客户集中度较高的风险

报告期内，发行人前五大客户的销售收入合计分别为 50,563.95 万元、135,804.49 万元和 380,807.45 万元，占营业收入的比例分别为 94.70%、89.80%和 70.14%，客户集中度较高。发行人目前与主要客户维持了长期业务往来关系并与部分客户签署了长期框架协议，如果发行人的主要客户生产经营出现问题，导致其向发行人下达的订单数量下降，则可能对发行人的业绩稳定性产生影响。未来，若发行人无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，将可能对发行人经营业绩产生不利影响。

（5）供应商集中度较高的风险

报告期内，发行人向前五大原材料供应商采购额合计分别为 21,284.22 万元、

33,895.37 万元和 59,363.58 万元，占原材料采购总额比例分别为 64.44%、53.58%和 47.35%，供应商集中度较高。

报告期内，发行人向境外供应商采购主要设备占比分别为 99.23%、94.26%和 95.31%，虽然在报告期内呈现出一定的下降趋势，但是发行人向境外供应商采购主要设备占比仍然较高，存在依赖境外供应商的情形；硅片采购方面，发行人硅片采购主要集中于 Global Wafers Co., Ltd.，占比超过 81.17%以上，存在单一供应商依赖及境外供应商依赖的情形。

如未来由于贸易摩擦、关税制度或其他不可抗力因素导致原材料或设备供应商延迟交货、限制供应或提高价格，致使发行人原材料或生产设备无法顺利取得或取得成本大幅增加，而发行人未能及时找到替代供应商，则发行人持续生产经营能力将受到不利影响。

（6）IP 授权商终止对公司授权的风险

根据集成电路行业垂直分工模式，主要可分为芯片设计企业、芯片制造企业、芯片封测企业，此外还有设备制造商、IP 授权商等。其中 IP 授权商设计特定功能的集成电路模块并提供给其他集成电路公司使用，通过收取技术授权费用的方式营利。

报告期内，发行人与 IP 授权商签订了技术授权协议，通过支付设计服务费及权利金的方式取得相关第三方 IP 授权。报告期内，发行人使用了上述第三方 IP 授权的产品所形成的主营业务收入占发行人主营业务收入的比重分别为 80.04%和 77.58%及 69.38%。

以上授权 IP 为发行人相应技术平台的重要组成部分，如发行人在技术授权协议到期后，因贸易摩擦、国际政治、不可抗力等因素，无法与其中部分 IP 授权商继续签订授权协议或取得 IP 授权成本大幅增加，且发行人无法在合理期限内自行开发或找到其他 IP 授权商，则会对发行人正常生产经营产生不利影响。

（7）国际贸易摩擦的风险

发行人使用的主要生产设备，硅片、设备零配件等主要原材料均主要通过向境外企业采购取得。发行人的部分主要客户亦为境外企业，报告期各期，发行人向境外客户销售产品实现主营业务收入分别为 46,771.80 万元、126,253.69 万元和 317,382.24 万元，占公司主营业务收入比例为 87.69%、83.51%和 58.55%。

未来，如果因贸易摩擦、国际政治、不可抗力等因素造成公司设备、原材料进口成本增加，产品境外销售利润率下降。基于目前国际政治环境、多边合作关系变动、各大经济体贸易政策存在不确定性，发行人的境外采购及销售可能因此受到影响。倘若未来国际贸易环境发生重大不利变化，一方面，发行人直接向境外采购可能会受到不利影响，另一方面，发行人的中国大陆供应商可能会受到不利影响进而使发行人的采购受到不利影响，该等不利影响可能将导致发行人无法采购相关生产设备或生产设备的零配件，进而可能导致发行人面临关键设备采购不到位影响生产的风险。

（8）产业政策变化的风险

近年来，国务院推出了《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）、《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等多项产业政策，促进集成电路行业发展；我国各级政府亦为集成电路企业提供了相关政策支持，在财税、投融资、研究开发、人才、知识产权等方面给予一系列优惠措施，进一步加强信息产业的创新能力和国际竞争力。如未来上述产业政策出现不利变化，将对发行人的业务布局、人才引进、生产经营产生一定不利影响。

（9）报告期内，发行人与力晶科技及力积电从事同类型业务的风险

报告期内，发行人与力晶科技及力积电均从事晶圆代工业务。力晶科技与发行人独立开展经营，力晶科技作为发行人股东，通过委派董事正常参与发行人具体生产经营管理，不存在通过股东地位及委派董事导致双方非公平竞争、利益输送、相互或单方让渡商业机会的情形。倘若未来公司治理和内部控制体系不能有效运行，内部管理不能适应发展需要，将影响公司持续、稳定、健康的发展。

（10）力晶科技未来退出影响发行人后续经营的风险

在公司治理方面，晶圆代工行业具有较高的专业性，力晶科技系半导体行业国际知名企业，在晶圆代工领域具有多年的行业经验，力晶科技及其提名的董事在参与公司董事会、股东大会时，对于公司治理方面起到积极促进作用，公司的经营及重大决策在目前的治理结构下运行稳定。未来，如力晶科技退出发行人，公司现有股东大会、董事会的结构将发生变化，若发行人未能及时找到合适的董事人选，或新进股东、新任董事不认同公司目前的管理层及经营策略，可能会对公司治理造成不利影响。

3、内控风险

（1）控股股东控制的风险

截至本上市保荐书出具之日，发行人控股股东合肥建投及其一致行动人合肥芯屏合计控制发行人本次发行前 52.99%的股份。本次发行完成后，发行人控股股东仍为合肥建投。虽然发行人已建立起旨在保护全体股东利益的法人治理机构和公司制度，但不能排除在本次发行后控股股东通过行使表决权对发行人的重大经营、人事决策等进行控制进而影响其他股东利益的可能性。

（2）公司规模扩张带来的管理风险

报告期内，发行人进行新厂建设，资产规模、业务规模和员工数量均持续增长。截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，发行人总资产分别为 1,137,349.83 万元、1,564,233.24 万元和 3,127,227.47 万元，发行人员工总数分别为 1,365 人、1,666 人和 2,720 人。公司规模的快速扩张会使得发行人的组织结构和经营管理趋于复杂化，对发行人的管理水平将提出更高的要求。此外，发行人成功上市后，也将面对资本市场的考验和更高的管理要求，发行人可能存在一定的管理风险。

4、财务风险

（1）经营业绩下滑的风险

报告期各期，发行人营业收入分别为 53,392.17 万元、151,237.05 万元和 542,900.93 万元，归属于母公司普通股股东的净利润分别为-124,302.67 万元、-125,759.71 万元和 172,883.20 万元。

未来，随着发行人产销量的提高，预计发行人的营业收入将有所上升，盈利水平逐步改善，发行人整体经营业绩将有所提升，但不排除未来受市场规模变化、行业竞争加剧、产品更新换代等因素综合影响，下游市场需求可能发生波动。如果发行人未能及时应对上述市场变化，将面临经营业绩下滑的风险。

（2）政府补助政策变化风险

报告期各期，发行人获得的计入当期损益的政府补助金额分别为 7,707.01 万元、8,706.06 万元和 18,975.01 万元，均属于非经常性损益。未来，若政府部门对发行人的支持政策发生变化，发行人能否继续获得政府补助以及获得政府补助的金额等存在不确

定性，进而对发行人盈利水平产生一定的影响。

（3）应收账款坏账风险

报告期各期末，发行人应收账款账面余额分别为 10,774.64 万元、26,522.01 万元和 94,885.30 万元，应收账款账面余额占当期营业收入的比例分别为 20.18%、17.54%和 17.48%。发行人应收账款集中度较高，报告期内前五大应收账款账面余额占比分别为 97.85%、97.26%和 76.09%。若出现宏观经济环境不佳、行业周期景气度差、重要客户经营状况出现恶化等不利情形，发行人可能存在应收账款发生坏账的风险。

（4）存货跌价风险

报告期各期末，发行人的存货账面价值分别为 16,352.69 万元、38,579.42 万元和 78,700.55 万元，占总资产比例分别为 1.44%、2.47%和 2.52%，呈现不断增长态势。

报告期各期末，发行人的存货跌价准备金额分别为 18,194.15 万元、3,559.33 万元和 2,315.43 万元，对应期末余额的计提比例分别为 52.67%、8.45%和 2.86%。发行人存货跌价准备的计提主要系公司尚处于产能、产量爬坡阶段，同时由于设备等生产性长期资产投入大，单位产品承担较大的折旧、摊销导致单位产品生产成本高于可变现净值，进而计提较多存货跌价准备。如果未来发行人产能、产量爬坡未达预期，可能持续存在存货跌价风险。

（5）固定资产建设投资风险

晶圆代工行业属于典型的资本密集型行业，固定资产投资的需求较高、设备购置成本高，而发行人近年为紧抓行业发展机遇积极进行产能扩充，固定资产投资规模较大。截至 2021 年末，发行人固定资产的账面价值为 1,632,598.75 万元，占发行人总资产的比例为 52.21%；发行人在建工程的账面价值为 332,905.83 万元，占发行人总资产的比例为 10.65%。发行人持续的产能扩充对后续资金投入提出了较高要求，发行人的资金筹措能力面临较大的考验。同时，若发行人未来收入规模的增长无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧，发行人将面临盈利能力下降的风险。

（6）无形资产减值风险

报告期各期末，发行人的无形资产账面价值分别为 176,896.01 万元、129,948.64 万元和 125,422.67 万元，占非流动资产的比例分别为 18.86%、12.43%和 5.24%。发行人

的无形资产主要由专利构成。

报告期内，发行人每年均对无形资产进行减值测试。2019 年度未计提无形资产减值准备；2020 年度，发行人受新冠肺炎疫情爆发、产品结构规划调整等因素影响，当期计提无形资产减值准备 29,573.92 万元；2021 年度发行人无形资产因未有减值迹象而未计提减值准备。如果未来出现市场环境变化、产业变革、技术更新迭代等导致发行人产品市场需求下降的情形，则可能有继续产生无形资产减值的风险，从而对发行人当期损益造成不利影响。

（7）偿债能力下降的风险

为满足较大资本开支需求，发行人的有息借款与资产负债率维持在较高水平。报告期各期末，发行人的有息借款分别为 508,667.76 万元、497,059.11 万元和 803,857.74 万元，发行人资产负债率（合并）分别为 66.33%、54.24%和 68.38%。目前发行人尚处于产能持续扩充阶段，后续资金投入需求较高，若未来发行人不能保持较好的盈利能力并有效拓宽融资渠道，将面临一定偿债能力下降的风险。

（8）汇率波动风险

发行人的记账本位币为人民币，而部分交易采用美元、日元等外币计价。报告期内，发行人汇兑损益分别为-2,136.50 万元、-3,246.73 万元和 14,346.43 万元。发行人在经营过程中重视外币资产和外币负债在规模上的匹配，合理控制外汇风险敞口。但未来若境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得本外币汇率大幅波动，发行人仍将面临汇兑损失的风险。

5、法律风险

（1）核心技术失密风险

发行人拥有若干具有自主知识产权的核心技术，是发行人保持行业竞争优势的关键和核心竞争力的体现，发行人核心技术人员的稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要。若发行人未来不能有效保护知识产权、核心技术及商业秘密，则可能削弱发行人核心竞争优势，进而对发行人的生产经营产生不利影响。

（2）知识产权风险

发行人所处的半导体行业属于典型的技术密集型行业。发行人一方面重视自身研发

体系的自主性与合规性，竭力避免自身技术和产品落入竞争对手专利的保护范围；另一方面发行人也重视对自主知识产权的保护，建立了知识产权保护体系。若发行人被第三方提出知识产权侵权指控，或者发行人自身的知识产权被第三方侵犯，将导致公司发生知识产权纠纷或诉讼，对发行人的生产经营造成不利影响。

（3）向控股股东子公司租赁主要生产经营用地及厂房的风险

截至本上市保荐书出具之日，发行人及其子公司均无自购或自建房产，发行人所有生产经营场所均为租赁。发行人主要生产经营用地、厂房位于安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号，其土地使用权及房屋所有权系控股股东子公司合肥蓝科拥有。

2017 年 6 月 28 日，合肥蓝科与晶合有限已签订《电子器件厂房设施租赁合同》，约定晶合有限租赁电子器件厂房，租赁期限自 2017 年 6 月 28 日（交付日）至 2037 年 6 月 27 日（终止日），且如发行人无重大营运问题，将自动按原条件续约。2021 年 4 月 8 日，合肥蓝科同发行人已签订《晶合二厂厂务及配套项目租赁合同》，约定租赁范围为晶合二厂洁净室与厂务设施及配套设施，租赁期限为 10 年，具体起租时间以实际交付日为准，租赁期满后，发行人有优先承租权，续租协议由双方另行协商确定。

2021 年 8 月 12 日，发行人召开 2021 年第一届第六次董事会审议通过了《关于变更上市募投项目的议案》。2021 年 8 月 27 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。募投项目变更后，拟使用 31 亿募集资金用于收购制造基地厂房及厂务设施，以保证发行人的独立性及资产的完整性。

但若租赁合同到期后，新租赁合同商务条款发生重大不利变化或产权人不愿与发行人续签新租赁合同，或发行人未来收购制造基地厂房或者厂务设施存在障碍等，发行人将面临续租成本增加甚至无法续租的风险。若发行人此时未拥有能够替代的土地、房产，将会对发行人的生产经营产生不利影响。

（4）安全生产风险

发行人高度重视安全生产，制定了完备的安全生产管理规范，建立了完善的安全生产管理体系。但由于发行人的生产工艺复杂，在生产中会使用操作难度高的大型设备、腐蚀性化学品等，存在一定危险性且对操作人员的技术要求较高。如果员工在日常生产中出现操作不当、设备使用失误等意外事故，发行人将面临安全生产事故、人员伤亡及

财产损失等风险。

（5）环境保护风险

发行人的生产过程会产生废水、废气、固体废弃物和噪声，需遵守环境保护方面的相关法律法规。发行人在日常生产经营过程中，积极配合当地环境保护部门履行环保义务，投入大量人力、财力、物力完善环保设施、提高环保能力，并制定了严格的环保制度。但随着国家对环境保护的日益重视，民众环保意识的不断提高，有关国家政策、法律法规的出台可能对发行人的生产经营提出更为严格的要求。若发行人不能及时对生产设施进行升级改造以提高对废水、废气和固体废弃物的处理能力，满足更为严格的环保标准和环保要求，甚至发生环境污染事件，将给发行人生产经营带来不利影响。

6、本次发行失败的风险

根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》等要求，若本次发行时提供有效报价的投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求，或者发行时总市值未能达到预计市值上市条件，本次发行应当中止。若发行人中止发行上市审核程序超过上交所规定的时限或者中止发行注册程序超过 3 个月仍未恢复，或者存在其他影响发行的不利情形，将会面临发行失败的风险。

7、存在累计未弥补亏损的风险

（1）公司在未来一定期间可能无法持续盈利或无法进行利润分配的风险

报告期内，发行人归属于母公司普通股股东的净利润分别为-124,302.67 万元、-125,759.71 万元和 172,883.20 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为-134,752.99 万元、-123,333.42 万元和 153,364.72 万元。发行人在有限责任公司整体变更为股份有限公司时，截至股改基准日 2020 年 9 月 30 日存在累计未弥补亏损，主要系发行人股改时尚处于产能爬坡阶段，营业收入不能覆盖同期发生的研发、生产、人力等较大的成本费用支出，截至 2021 年末，发行人经审计的未分配利润为-263,975.26 万元，发行人可供股东分配的利润为负值。

截至本上市保荐书出具之日，发行人仍在产能爬坡阶段，虽然 2021 年度发行人已实现盈利，但若盈利无法持续，则发行人在短期内无法弥补累计亏损。预计首次公开发行股票并上市后，发行人短期内无法进行现金分红，对投资者的投资收益造成一定影响。

（2）公司在资金状况、研发投入、业务拓展、人才引进、团队稳定等方面可能受到限制或存在负面影响的风险

报告期各期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-18,303.30 万元、47,282.88 万元和 957,388.50 万元。发行人目前处于高速发展阶段，在研项目、产能扩充均需持续投入大量资金，若未来发行人经营活动无法维持充足的现金流，则可能面临资金受限而导致的业务拓展困难、人才引进和团队稳定困难、研发投入不足的风险、市场开拓无法达到预期的风险等。

8、与募集资金相关的风险

发行人本次公开发行股票募集资金将投入以下项目：

序号	项目名称	实施主体	拟使用募集资金额（亿元）
1	合肥晶合集成电路先进工艺研发项目	晶合集成	49.0
1.1	后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）	晶合集成	6.0
1.2	微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）	晶合集成	3.5
1.3	40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目	晶合集成	15.0
1.4	28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目	晶合集成	24.5
2	收购制造基地厂房及厂务设施	晶合集成	31.0
3	补充流动资金及偿还贷款	晶合集成	15.0
合计			**95.0**

本次募集资金投资项目金额较大，新增研发工艺平台种类及数量较多，募集资金投资项目是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素所作出的安排，项目实施与未来行业竞争情况、市场供求状况、技术进步等因素密切相关。如果未来 DDIC、CIS、MCU、OLED 芯片等产品的市场需求或该等产品的终端应用的市场需求不及预期，行业竞争加剧或集成电路市场环境发生重大变化，或如果未来后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台、微控制器芯片工艺平台、40 纳米逻辑芯片工艺平台和 28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台的研发失败或研发成果不达预期，募集资金投资项目未能按照计划顺利实施，发行人则可能面临无法按既定计划实现预期收益的风险。

9、公司触发退市条件的风险

未来发行人上市后，若生产经营环境发生重大不利变化，或者公司经营决策出现重大失误，发行人将可能持续亏损，营业收入、净资产大幅下降，导致营业收入低于 1 亿元，或者净资产为负，触发退市风险警示标准，甚至出现明显丧失经营能力情形，从而触发退市标准，出现退市风险。

同时，未来发行人上市后，若生产经营环境发生重大不利变化，或者公司经营决策出现重大失误，发行人股票投资价值将大幅下降，将可能出现交易不活跃情形，股票市值及交易价格、股票交易量、股东数量可能因公司投资价值大幅降低而触发退市标准，出现退市风险。

二、申请上市股票的发行情况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次公开发行不超过 501,533,789 股（行使超额配售选择权之前），本次拟公开发行人民币普通股（A 股）占公司发行后总股本的比例不超过 25%（行使超额配售选择权之前），并授予主承销商不超过前述发行的人民币普通股（A 股）股数 15%的超额配售选择权
每股发行价格	人民币【】元
发行方式	采用向网下投资者配售与网上向投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他方式
发行对象	符合资格的网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象
承销方式	余额包销
拟申请上市证券交易所	上海证券交易所科创板

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

周玉：于 2016 年取得保荐代表人资格，曾经担任中国广核电力股份有限公司 A 股 IPO 项目、杭州银行股份有限公司 A 股非公开发行项目等项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

龙亮：于 2012 年取得保荐代表人资格，曾经担任中海油能源发展股份有限公司 A

股 IPO 项目、中国电信股份有限公司 A 股 IPO 项目、广州汽车集团股份有限公司 A 股可转换公司债券项目等项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

项目协办人：梁晶晶，于 2008 年取得证券从业资格，曾经执行国电电力发展股份有限公司 A 股公开增发项目、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 A 股公开增发项目、杭州银行股份有限公司 A 股 IPO 项目、中国电信股份有限公司 A 股 IPO 项目等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）项目组其他人员情况

项目组其他成员：刘飞峙、艾雨、郭宇泽、卓一帆、乔达、李义刚、黄泽瑞、徐振飞、孙起帆、章响、余朝辉、陈书慧。

四、保荐机构与发行人之间的关联关系

1、本机构自身及本机构下属子公司持有或通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况：

截至本上市保荐书出具之日，中金公司通过全资子公司中金浦成持有发行人 0.12%的股份；根据国家企业信用信息公示系统公开信息显示，中金公司通过其以自有或投资的已经基金业协会备案的相关金融产品等形式间接持有发行人股东中小企业基金、集创北方、宁波华淳的股权/财产份额（穿透后持有发行人股份的比例不超过 0.01%），该等投资行为并非中金公司主动针对公司进行投资（投资公司第九层及以上间接股东）。

中金公司作为本次发行项目的保荐机构，严格遵守相关法律法规及监管要求，切实执行内部信息隔离制度，充分保障保荐机构的职业操守和独立性。中金公司已建立并实施包括《限制名单政策》在内的信息隔离墙制度，在制度上确保各业务之间在机构设置、人员、信息系统、资金账户、业务运作、经营管理等方面的独立隔离机制及保密信息的妥善管理，以防范内幕交易及避免因利益冲突产生的违法违规行为。

中金浦成作为发行人的发起人之一，持有发行人股份依据其自身独立投资研究决策，

与本次项目保荐并无关联。

截至本上市保荐书出具之日，本机构自身、本机构下属子公司及本机构控股股东、实际控制人、重要关联方合计持有的晶合集成的股份占晶合集成股份总数的 0.12%。上述情形不违反《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十二条的规定，不会影响保荐机构公正履行保荐职责。

本机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。本机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。

除此之外，本机构自身及本机构下属子公司不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的其他情况。

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方除可能存在的少量二级市场投资外，不存在持有本机构及本机构下属子公司股份的情况。

3、本机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

4、中金公司控股股东为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”或“上级股东单位”），截至 2021 年 12 月 31 日，中央汇金及其全资子公司中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司、中国投资咨询有限责任公司合计持有中金公司约 40.17%的股份。中央汇金为中国投资有限责任公司的全资子公司，中央汇金根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。中央汇金不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。根据发行人提供的资料及公开信息资料显示，中金公司上级股东单位与发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互持股的情况，中金公司上级股东单位与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互提供担保或融资的情况。

5、本机构与发行人之间不存在其他关联关系。

综上所述，本机构依据相关法律法规和公司章程，独立公正地履行保荐职责。

五、保荐机构承诺事项

（一）本机构已按照法律法规和中国证监会、上交所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查和审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

本机构同意推荐合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。

（二）作为合肥晶合集成电路股份有限公司本次发行的保荐机构，本机构：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规、中国证监会以及上交所有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证本上市保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会以及上交所的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会、上交所依照相关法律、行政法规采取的监管措施。

六、本次发行履行了必要的决策程序

经核查，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会、上

交所规定的决策程序，具体如下：

（一）董事会决策程序

2021 年 2 月 9 日，发行人召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于合肥晶合集成电路股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》、《关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》、《关于<合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并科创板上市后股东分红回报三年规划>的议案》、《关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案的议案》、《关于<合肥晶合集成电路股份有限公司滚存未分配利润分配方案>的议案》、《关于合肥晶合集成电路股份有限公司出具上市相关承诺及提出约束措施的议案》、《关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于上市后适用的<合肥晶合集成电路股份有限公司章程（草案）>的议案》等与本次发行相关的议案，对本次发行的具体方案以及其他必须明确的事项作出了决议，并提请股东大会审议；2021 年 8 月 12 日，发行人召开 2021 年第一届第六次董事会审议通过了关于变更上市募集资金投资项目的议案，并提请股东大会审议。

（二）股东大会决策程序

2021 年 3 月 16 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了本次发行相关的议案；发行人已于 2021 年 8 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议关于变更上市募集资金投资项目的议案；2022 年 3 月 16 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案有效期的议案》《关于提请股东大会继续授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》。

综上，保荐机构认为，发行人本次发行已获得董事会、股东大会的批准，发行人董事会已取得股东大会关于本次发行的授权，发行人就本次发行履行的决策程序符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规以及发行人公司章程的相关规定。

七、针对发行人是否符合科创板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，保荐机构的核查内容和核查过程

（一）发行人符合科创板行业领域的核查情况

发行人主要从事 12 英寸晶圆代工业务，致力于研发并应用行业先进的工艺，为客户提供多种制程节点、不同工艺平台的晶圆代工服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，发行人所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）”。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所处行业为第 39 大类“计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》（国家统计局令第 23 号），发行人所处行业为战略性新兴产业分类中的“新型电子元器件及设备制造”（分类代码：1.2.1）及“集成电路制造”（分类代码：1.2.4）。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2012)（试行）》，发行人所处行业为战略性新兴产业分类中的“基础电子元器件及器材制造”（分类代码：2.2.5）及“集成电路”（分类代码：2.2.6）。

根据《暂行规定》第四条第一款“新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”，发行人所处行业属于新一代信息技术行业领域中的半导体和集成电路产业。

此外，与发行人同属晶圆代工行业的科创板上市公司中芯国际（688981.SH）所处行业亦为第 39 大类“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业分类与发行人一致。

经核查，保荐机构认为，发行人主营业务与所属行业领域归类匹配，与可比公司行业领域归类不存在显著差异。

（二）发行人符合科创属性要求的核查情况

1、发行人最近三年研发投入占营业收入比例为 10.86%、最近三年研发投入累计为 81,153.85 万元，符合《暂行规定》第五条第一款关于研发投入的规定。

保荐机构查阅了发行人的审计报告，获取了发行人报告期内研发费用明细及研发项目立项文件，抽取并核对了大额研发费用支出的凭证，就公司研发费用的核算进行审慎

核查。

经核查，保荐机构认为发行人最近三年累计研发投入及占最近三年累计营业收入的比例真实、准确。

2、截至 2021 年 12 月 31 日，发行人共有研发人员 480 人，占当年员工总数的 17.65%；发行人报告期各期末研发人员占当年员工总数的比例平均为 16.54%，符合《暂行规定》第五条第二款关于研发人员的规定。

保荐机构取得了发行人员工名册，并审阅了发行人计入研发费用的员工薪酬明细。

经核查，保荐机构认为发行人研发人员的数量及占比数据真实、准确。

3、截至 2021 年 12 月 31 日，发行人在报告期内形成主营业务收入的发明专利共 198 项，符合《暂行规定》第五条第三款关于发明专利的规定。

保荐机构核查并取得了发行人的全部专利证书，网络检索并查询了发行人专利情况，取得发行人在中国境内专利的登记簿副本的证明，对发行人列报的发明专利权利归属、有效期限、有无权利受限或诉讼纠纷以及在主要产品（服务）中的应用情况等进行核查。

经核查，保荐机构认为发行人形成主营业务收入的发明专利数量真实、准确。

4、发行人最近 3 年营业收入复合增长率为 218.88%，最近一年（2021 年度）营业收入金额为 542,900.93 万元，符合《暂行规定》第五条第四款关于营业收入复合增长率及营业收入金额的规定。

保荐机构查阅发行人的审计报告，对重要客户进行函证和访谈，对发行人进行资金流水核查和销售收入穿行测试，就公司营业收入的真实性和增长情况进行核查。

经核查，保荐机构认为发行人营业收入金额真实、准确。

八、保荐机构关于发行人是否符合《科创板上市规则》规定的上市条件的逐项说明

（一）发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条之“（一）符合中国证监会规定的发行条件”规定

根据《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发

行股票并在科创板上市的发行保荐书》之“三、本机构对本次证券发行的推荐意见”之“（三）本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件”和“（四）本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件”，发行人符合《证券法》《注册管理办法》规定的公开发行股票的条件，符合中国证监会规定的发行条件，符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条第（一）项的规定。

（二）发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3000 万元”规定

经核查，发行人本次发行前股本总额为 1,504,601,368 元，本次拟发行股份不超过 501,533,789 股（不考虑超额配售选择权），发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元，符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

（三）发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定

经核查，本次拟发行股份不超过 501,533,789 股（不考虑超额配售选择权），发行后公司股本总额不超过人民币 2,006,135,157 元，公开发行的股份达到公司股份总数的 10%以上，符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

（四）发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条之“（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定

1、发行人本次上市选择的标准

发行人结合自身状况，选择适用《科创板上市规则》第 2.1.2 条规定的上市标准中的第四套标准“预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”。

2、发行人预计市值符合上市标准

经核查，发行人结合报告期内的外部股权融资情况、可比公司在境内外市场的估值情况，基于对发行人市值的预先评估，预计发行后总市值不低于 30 亿元。

3、发行人财务指标符合上市标准

经核查，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字

[2022]230Z0100 号），发行人最近一年营业收入为 542,900.93 万元，满足其所选择的上市标准。

（五）发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条之“（五）上海证券交易所规定的其他上市条件”规定

经核查，发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

九、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

事项	安排
（一）持续督导事项	在本次发行的股票上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度对发行人进行持续督导。
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止控股股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度； 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度； 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	1、督导发行人有效执行并进一步完善《公司章程》、《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度； 2、督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见。
4、持续关注发行人募集资金的专户存储、使用、投资项目的实施等承诺事项	1、督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度，保证募集资金的安全性和专用性； 2、持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项； 3、如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。
5、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	1、督导发行人执行已制定的《对外担保管理制度》等制度，规范对外担保行为； 2、持续关注发行人为他人提供担保等事项； 3、如发行人拟为他人提供担保，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。
6、督促发行人建立和执行信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度	1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的信息披露、分红规划等制度，并督导发行人履行相关承诺及规范运行； 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务等方面的情况。
7、识别并督促发行人披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重	1、督导发行人及时准确地披露对核心竞争力、控制权稳定性等方面有重大不利影响的事项；

事项	安排
大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见	2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
8、持续关注发行人股票交易异常波动情况，督促发行人按照本规则规定履行核查、信息披露等义务	督导发行人及时向保荐机构通报股票异常波动情况，并及时履行信息披露义务。
9、对发行人存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告	针对可能严重影响发行人或投资者合法权益的事项，对发行人进行现场检查，并督导发行人即刻汇报相关工作。
（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	1、指派保荐代表人或其他保荐机构工作人员或保荐机构聘请的第三方机构列席发行人的股东大会、董事会和监事会会议，对上述会议的召开议程或会议议题发表独立的专业意见； 2、指派保荐代表人或保荐机构其他工作人员或聘请的第三方机构定期对发行人进行实地专项核查。
（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	1、发行人已承诺全力支持、配合保荐机构做好持续督导工作，为保荐机构的保荐工作提供必要的条件和便利，及时、全面提供保荐机构开展保荐工作、发表独立意见所需的文件和资料，并确保公司高管人员尽力协助保荐机构进行持续督导； 2、发行人应聘请律师事务所和其他证券服务机构并督促其协助保荐机构在持续督导期间做好保荐工作。

十、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式

保荐机构：　　中国国际金融股份有限公司

法定代表人：　　沈如军

住所：　　北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系电话：　　010-65051166

传真：　　010-65051156

保荐代表人：　　周玉、龙亮

十一、保荐机构认为应当说明的其他事项

无其他应当说明的事项。

十二、保荐机构对本次上市的推荐结论

本机构认为，发行人申请其股票上市符合《公司法》《证券法》及《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定，发行人股票具备在上海证券交易所科创板上市的条件，同意推荐发行人在上海证券交易所科创板上市。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市保荐书》之签署页）

法定代表人、董事长签名：

沈如军

中国国际金融股份有限公司

2022 年 4 月 11 日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市保荐书》之签章页）

首席执行官签名：

黄朝晖

中国国际金融股份有限公司

2022 年 1 月 11 日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市保荐书》之签章页）

保荐业务负责人签名：

孙　雷

内核负责人签名：

杜祎清

保荐代表人签名：

周　玉　　龙　亮

项目协办人签名：

梁晶晶

保荐机构公章

中国国际金融股份有限公司

2022 年 4 月 11 日